

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

524

ML6

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

10.08.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	μm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	---------------	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1	
A-RS-FR4-Prepreg-106-TG150-HF	50200640	85		2	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3	
		70	L2		
C-RS-FR4-ML-0.10mm-070+070-TG150-HF	50200773	100		4	A01
		70	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	160		5	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		6	B00
		70	L4		
C-RS-FR4-ML-0.10mm-070+070-TG150-HF	50200773	100		7	A02
		70	L5		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	85		8	
A-RS-FR4-Prepreg-106-TG150-HF	50200640	0		9	
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	10	

Dicke nach Verpressen

B00:

890 μm

Tol+:

100 μm

Tol-:

100 μm

Dmax:

990 μm

Dmin:

790 μm

Gesamtdicke über alles

0 μm

Tol+:

0 μm

Tol-:

0 μm

Dmax:

0 μm

Dmin:

0 μm

Kundenforderung

Dicke (D):

1000 μm

Tol+:

100 μm

Tol-:

100 μm

Dmax:

1100 μm

Dmin:

900 μm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

846 μm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik